

Job Detail

Company Code:88428 Job Code:20230711-112-01-090

Manager Level

Position Title	【工程管理(ワイヤーボンディング工程)熊本】不良率削減・生産性改善
Recruiter Company	株式会社 リクルート（リクルートエージェント / Recruit Agent）
Company Name	(株)アムコー・テクノロジー・ジャパン
Activated / Updated	2024-05-20 / 2024-05-21
Job Type	Electronics (Appliance/Semiconductor) - Control - Programmer
Industry	Electronics, Components, and Semiconductor Manufacturing
Location	Asia Japan Kumamoto
Job Description	<p>世界シェア2位、日本ではシェア1位の半導体後工程受託メーカーにて、ワイヤーボンディング工程における生産性改善・向上、不良率削減、コスト低減などの取り組みをお任せします。</p> <p>■ワイヤボンド工程担当(条件出し、生産性改善、不具合改善、データ纏め) ■アセンブリ全般 生産性改善、生産性向上、不良率削減、コスト低減</p> <p>【働き方】フレックス制度：業務を調整しつつ活用することが可能です。</p>
Company Info	<p>■半導体後工程受託(ウェハテスト、アッセンブリ、ファイナルテスト、ベアチップ、外観検査、パッケージ・テスト開発)</p> <p>従業員数 3500名</p>
Qualifications	<p>【必須】■半導体に関する業務経験■生産性改善、不良率削減、コスト低減等に従事した経験</p> <p>【会社について】■導体製造の「後工程」に特化し、業界を牽引しているリーディングカンパニー。業界シェアは世界第2位、国内ではトップに位置し、革新的な事業展開で半導体の発展に寄与。 ■半導体パッケージ・テスト企業 国内売上No.1、アムコーグループでは世界で売上No.2。世界でトップクラスの品質と技術力を持った半導体のパッケージ・テスト企業。</p>
English Level	Business Conversation Level (TOEIC 735-860)
Japanese Level	Fluent(JLPT Level 1 or N1)
Salary	JPY - Japanese Yen JPY 3500K - JPY 6500K
Holiday Description	年間休日 120日
Job Contract Period	正社員